

上海季丰电子股份有限公司（闵行总部）
职业病危害因素检测报告信息公开表

2023-11-21

单位名称	上海季丰电子股份有限公司（闵行总部）	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海闵行区友东路288号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氢氧化钠、氟化氢、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氨、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、乙酸丁酯、异丙醇、二氧化锡、其他粉尘、甲苯、激光辐射、噪声
	检测结果	化学因素 <u>20</u> 个，物理因素 <u>7</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>27</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>27</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：胡轶文、刘彬 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：姜荣 陪同人员：姜荣
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.10.30 采样时间：2023.10.30 检测时间：2023.10.30-2023.11.10

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



